**國家中山科學研究院材料暨光電研究所**

**108年度第十四次專案人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

需求全時工作人員研發類47員、技術生產類15員、行政管理類1員，共計63員，依「國家中山科學研究院材料暨光電研究所108年度第十四次專案人力進用員額需求表」辦理（如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：依本院**新進人員薪資核敘基準表之薪資範圍內，核給基本薪。**

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)得依條件申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)轉任人員，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(持國外學歷者須符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格)。

(一)研發類：

1.碩士(含)以上畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具論文、成績單及學校開立證明書認定，或檢具學分證明資料由本院專業單位審查。

3.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(二)技術生產類：

1.高中(含)以上畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核 薪。

(三)行政管理類：

1.大學畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

三、其他限制：具有下列情形之一者，不得辦理進用；若於進用三個月內，本院始查覺者，得取消錄取資格︰

(一) 履歷內容填寫不實或於應徵過程中為虛偽意思表示及舞弊者。

(二)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(三)無行為能力或限制行為能力者。

(四)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(五)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。但情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。但情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(七)因案被通緝或在羈押、管收中。

(八)依法停止任用者。

(九)褫奪公權尚未復權者。

(十)受監護宣告尚未撤銷者。

(十一)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十二)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十三)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之懲罰者。

**肆、報名時間及方式：**

一、甄試簡章及職缺需求刊登於本院全球資訊網 (http://www.ncsist.org.tw)，公告報名至108年9月9日止。

二、 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw)填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件2)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷，各項資料並依序彙整在同一檔案(PDF檔)上傳。

三、需求單位於本院徵才系統資料庫搜尋並篩選符合報考資格者後

，辦理初步選員(資格審查)。

四、報考人員經初步選員 (資格審查)合格者，需求單位以電子郵件或簡訊或Line (擇一)通知參加甄試。

五、不接受紙本及現場報名甄試。

六、應屆畢業生報名甄試時尚未取得畢業證書者，僅需繳交學生證掃描檔查驗。前述人員錄取後，需於本院寄發錄取通知日起至報到日期間，繳驗畢業證書正本(如為學校因素無法如期繳交，須出具學校開立之佐證證明)，若無法繳驗，則取消錄取資格。

七、歡迎具身心障礙身分或原住民族身分，且符合報考資格者報名參加甄試，並於人才資料庫登錄資料時註記。

八、為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件4)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。

**伍、報名應檢附資料：**報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。**各項資料依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳。 報考職缺每人最多以三個為原則。**

一、履歷表(如附件2），並依誠信原則，確實填寫在本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，本院則予不經預告終止契約解除聘雇。

二、主管核章之各類聘僱員工參加招考報名申請表掃描檔(如附件3，僅本院同仁需繳交)。

三、符合報考學歷之畢業證書掃描檔。

四、報考所需之個人掃描檔資料(如：工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等，請參考簡章之員額需求表)。

五、提供工作經歷證明者，格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。

六、若有繳交非我國政府機構之工作經歷證明，需再檢附個人社會保險投保證明(如：勞保、公保、農保…等)，如未檢附，該工作經歷不予認可。

七、具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。

八、具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

一、甄試日期及時間：暫定108年 9月 (實際甄試時間以甄試通知為準)。

二、甄試地點：暫定桃園市龍潭區中科院新新或龍門院區(實際甄試地點以甄試通知單為準)。

三、甄試方式：

(一)研發類：

1.初試：書面審查與口試(配分請參考員額需求表)。

2.複試：口試(配分請參考員額需求表)。

(二)技術生產類：

1.初試：書面審查、實作/筆試與口試(配分請參考員額需求表)。

2.項次33筆試參考書籍請參照員額需求表甄試方式。

3.複試：口試(配分請參考員額需求表)。

(三)行政管理類：

1.初試：書面審查、實作與口試(配分請參考員額需求表)。

2.複試：口試(配分請參考員額需求表)。

1. 各項甄試作業如遇天災、事變及突發事件(如：颱風來襲)等不可抗力之原因，本所得視情況合理的調整甄試作業時間、地點及甄試方式並應即通知應考人員。
2. 各項甄試作業(如：時間、地點…等)均以電子郵件或簡訊或Line通知應考人員。請考生務必留意報考時提供之電子郵件帳號、手機號碼及Line。若以電子郵件、簡訊、Line通知無法聯繫到考生，視為該考生放棄報考，不再另行通知。
3. 研發類書面審查不合格者及技術生產類書面審查或筆試/實作不合格者，皆不通知參加口試。
4. 口試甄試時，若考生未於規定時間內完成報到手續，需主動以電話先行告知，報到時間得視情況順延(1小時內為原則)。

**柒、錄取標準：**

一、單項(書面審查/實作或筆試/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。

二、初、複試(口試)合格標準為70分(滿分100分)。

三、總成績合格標準為70分(滿分100分)。

四、如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。

五、成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取。

1.研發類、技術生產類、行政管理類：總成績為複試(口試)平均成績。

(二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由需求單位決定錄取順序。

2.技術生產類：依序以實作平均成績/筆試成績(若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由單位決定錄取順序。

3.行政管理類：依序以實作平均成績/筆試成績(若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由單位決定錄取順序。

六、備取人數：

(一)完成各階段甄試後合格但未錄取之應徵者得設為備取人員，並由單位依成績排定備取順序，依序備取，儲備期限自甄試結果奉院長核定次日起4個月內有效。

(二)人員錄取或遞補來院報到後，其他於本院應徵職缺之錄取或遞補皆視同自動放棄。

**捌、錄取通知：**

一、甄試結果預由本院於甄試後1個月內寄發通知單(或以電子郵件通知)，各職缺錄取情形不予公告。

二、人員進用：錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

總機：(03)4712201或(02)26739638

聯絡人及分機：材料暨光電研究所 林正裕組長357010

黃瑞婷小姐357231

劉佳珊小姐357268

line@帳號：@hwi9801m

(相關甄試期程亦會line上通知，請加入line以利聯繫。)

附件1

| **國家中山科學研究院材電所108年第14次專案人力進用員額需求表** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **需求**  **單位** | **職類** | **學歷**  **需求** | **薪資**  **範圍** | **專長**  **(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求**  **員額** | **工作**  **地點** | **甄試**  **方式** |
| 1 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 面議 | 資訊/數理/電子/電機/DSP程式撰寫 | 1.資(通)訊/電子/電機/控制/電信/生醫/光電等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)影像偵測追蹤法則、程式開發。  (2)影像處理模擬及程式開發驗證。  (3)DSP/微處理器嵌入式軟體開發與測試。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.影像處理演算法開發與程式驗證  2.DSP嵌入式軟體開發與測試（熟TI DSP為佳）。  3.C與Matlab軟體開發。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 2 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 面議 | 電子/電機/電路設計 | 1.電子/電機/控制/電信 /機電/光電等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)微處理器/DSP應用電路開發與測試。  (2)數位電路設計與測試。  (3)光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  2.數位電路設計與測試。  3.成像電路開發與測試。  4.視訊訊號介面轉換電路設計。  5.微處理器/DSP控制電路設計與測試。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 3 | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 面議 | 電子/電機/資訊/機電整合 | 1.電子/電機/資(通)訊/控制/電信/生醫/光電/動力機械/機電/精密等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)影像偵測追蹤法則、程式開發。  (2)影像處理模擬及程式開發驗證。  (3)DSP/微處理器嵌入式軟體開發與測試。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.影像處理演算法開發與程式驗證（具影片中物體偵測、追蹤法則及程式開發經驗為佳）  2.DSP嵌入式軟體開發與測試（熟TI DSP為佳）。  3.C與Matlab軟體開發（具程式優化經驗者為佳）。  4.系統流程及程式撰寫。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 4 | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 面議 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資(通)訊/控制/電信/生醫/光電/動力機械/機電/精密等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)微處理器/DSP應用電路開發與測試。  (2)數位電路設計與測試。  (3)光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩、博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.微處理器/DSP應用電路開發與測試。  2.數位電路設計與測試。  3.光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  4.視訊訊號介面轉換設計。  5.數位控制設計與測試。  6.伺服硬體控制電路設計。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 5 | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 電子/電機/光電/物理 | 1.電子/電機/資(通)訊/控制/電信/生醫/光電/動力機械/機電/精密等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)具光電元件與系統組、調、測等流程規劃及執行等相關工作經驗。  (2)具光電系統設計、性能評估分析、光電系統測試架構設計、光電參數量測與分析等相關工作經驗。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩、博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.光電系統設計、分析、測試之規劃及執行。  2.目標、背景等光電特性之模擬、量測與分析。  3.光電系統訊雜比、偵測率及誤差分析。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 6 | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 機械/動力機械/機電控制/航空 | 1.機械/動力機械/航空/輪機/機電/控制/精密等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)自動控制/控制系統之分析與設計。  (2)機電整合系統/機械與電機系統的整合應用。  (3)數位控制設計與測試。  (4)微處理器/DSP軔體程式開發及測試。  (5)伺服控制/伺服機構架構、規格、控制器設計。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.動態軸承機構系統設計。  2.伺服控制/伺服機構架構、規格、控制器設計。  3.機電系統整合應用。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **7** | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 材料 | 1.材料/機械/航空等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)超合金真空熔煉鑄造相關研發或製造。  (2)超合金方向性凝固鑄造相關研發或製造。  (3)金屬粉末氣體霧化製程模擬分析及相關製造技術開發。  (4)金屬積層製造技術相關研發或製造。  (5)絕熱塗層材料及製程技術開發。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士、博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.超合金真空熔煉鑄造技術開發。  2.超合金方向性凝固鑄造製程技術開發。  3.金屬粉末氣體霧化製程模擬分析及製造技術開發。  4.金屬積層製造技術及製程開發。  5.絕熱塗層材料及製程技術開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 8 | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 機械 | 1.機械/動力機械/應用力學/光機電/航空/造船/等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3. 具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)熟Solidworks與ANSYS等2D/3D軟體操作者為佳。  (2)具備機械/結構/熱傳/應力/靜力/動態分析/材料機械性質分析等專長為佳。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)博、碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.結構熱傳之設計與分析。  2.各式模治具設計開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 9 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/材料 | 1.機械/動力機械/應用力學/光機電/航空/造船/自動控制/材料等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3. 具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)熟Solidworks與ANSYS等2D/3D軟體操作者為佳。  (2)具備機械/結構/熱傳/應力/靜力/動態分析/材料機械性質分析等專長為佳。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.結構熱傳之設計與分析。  2.機構設計與應力分析  3.各式模治具設計開發。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **10** | 材電所 | 研發類 | 碩 士畢業 | 56,650  |  65,000 | 材料 | 1.材料/機械/航空/自動控制/造船等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)鈦合金真空熔煉鑄造相關研發或製造。  (2)真空熔煉鑄造相關研發或製造。  (3)金屬粉末相關製造技術開發。  (4)金屬積層製造技術相關研發或製造。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.鈦合金真空熔煉鑄造製程技術開發。  2.真空熔煉鑄造技術及製程開發。  3.金屬粉末製程技術開發。  4.金屬積層製造技術及製程開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 11 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械 | 1. 機械/動力機械/應用力學/航空/造船等理工系所畢業。   2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容相關工作技術經驗之一者為佳(請檢附證明資料)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.電池模組的封裝機構設計和水路管理。  2.電池製程設備機械設計。  3.產品的機械介面協調和技術資料整建。  4.熟悉電腦機械設計和繪圖(CAD) 如Solidworks等2D/3D軟體操作者為佳。  5.具備機械/結構靜力與動態分析為佳。 | 1員 | 桃 園  龍 潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 12 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電機 | 1.電子/電機/控制/電力 /機電/光電等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3. 具工作內容相關工作技術經驗之一者為佳(請檢附證明資料)。。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.電源管理系統設計開發。  2.電力控制管理監控系統設計開發。  3.儲能系統設計開發經驗。  4.具備自動化程式控制軟體撰寫能力。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 13 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/材料 | 1.機械/應用力學/造船/輪機/船舶/航空/航太/工程科學/材料等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照者為佳(請檢附證明文件)：  (1)曾執行複材結構設計、分析與製作開發等工作經驗。  (2)具機械/結構設計、振動與動態分析與量測工作經驗。  (3)具聲學或水下聲學分析與量測工作經驗。  (4)具各式模治具設計開發工作經驗。  (5)具機械類加工製造、檢驗與品管工作經驗。  (6)具力學模擬分析、Solidworks或 Catia設計軟體工作經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等證照。  (5)其它有助審查資料之文件。 | 1.複合材料結構設計、結構分析、開發與測試。  2.複合材料製程開發研究。 | 5員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 14 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/材料 | 1.電機/機械/造船/工程科學/海洋工程等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照者為佳(請檢附證明文件)：聲學或水下聲學分析與量測工作經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等證照。  (5)其它有助審查資料之文件。 | 水下聲學分析與量測。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 15 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 化學/化工/高分子/材料 | 1.化工/化學/高分子/材料等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照者為佳(請檢附證明文件)：  (1)高分子設計、分析與製作開發等工作經驗。  (2)樹脂合成測工作經驗。  (3)樹脂配方與改質工作經驗。  (4)複合材料工作經驗。  (5)樹脂性能模擬與特性研究工作經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等證照。  (5)其它有助審查資料之文件。 | 1.樹脂配方設計與改質。  2.複合材料製程開發研究。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **16** | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機/通訊 | 1.電子/電機/電信等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.至少需具備以下條件之一(請檢附相關經歷證明)：  (1)具微波元件(天線、放大器、耦合器、濾波器、微波電路等等)設計、分析及量測工作經驗。  (2)具頻率選擇表面(Frequency Selective Surface)、ANSYS HFSS設計與量測經驗尤佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.電性設計開發研究。  2.電性量測及優化。  3.產品製程規劃、界面協調、技術資料整建、專案計畫管制等。 | 1員 | 新北  三峽 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 17 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 專案管理/生產管理/系統工程 | 1.電子電機/機械/光電航空/造船/自動控制/工業工程等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中高級/ /TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附證明資料)：  (1)具專案管理/生產管理/物料管理/工業工程等相關工作經驗者。  (2)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.專案管理執行、專案建案、生產規劃與管制、合約管理等相關管制及系統整合工作。  2.資源分配、時程管制、風險管理與流程改善，品質稽核等工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 18 | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 機電控制/機械/動力機械/電子電機 | 1.機械/動力機械/航空/電子電機/機電/控制等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)機電整合系統/機械與電機系統的整合應用。  (2)伺服控制/伺服機構架構、規格、控制器設計。  (3)自動控制/控制系統之分析與設計。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.遙控火砲系統機電整合系統/機械與電機系統的整合應用。  2.遙控火砲系統伺服控制/伺服機構架構、規格、控制器設計。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 19 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機/光電/控制工程/資訊工程 | 1.電子/電機/控制/通訊/電信/資工/資訊/機械/光電/物理等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下(1)~(7)任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：   1. 具光電元件/物理模擬設計與分析工作經驗。 2. 具光電影像晶片及模組測試開發經驗。 3. DSP及FPGA相關軟硬體開發經驗。 4. 影像處理或信號處理或控制系統演算法開發經驗。 5. 其他與工作內容所列項目相關經驗。   4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)研究所(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表期刊第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 從事以下工作內容至少2項：  1.以COMSOL建立元件模型  2.以Tanner EDA 或相關tool進行元件設計，可並與COMSOL進行鏈結設計驗證。  3.MEMS晶圓Pre-Tapeout Job-view確認  4.熟悉光電元件測試法則，開發測試程式，操作半自動晶圓測台進行影像晶片性能分析。  5.測試與人機介面程式開發。  6.MEMS晶圓Post Tapeout測試規劃。  7.DSP韌體程式、應用電路開發。  8.FPGA Verilog 或VHDL程式開發。  9.影像處理或信號處理或控制系統演算法開發。  10.光機影像系統整合及性能測試。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 20 | 材電所 | 研發類 | 碩 士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 光電/電子/電機/物理 | 1.光電/物理相關系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下(1)~(4)任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)高功率半導體雷射二極體固晶封裝經驗。  (2)光學元件開發經驗。  (3)具光電/物理模擬分析工作經驗。  (4)其它與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 從事以下工作內容之一：  1.高功率半導體雷射固晶製程及測試驗證。  2.高功率半導體雷射激發源模組設計與開發。  3.準直鏡/鎖波長光電元件開發。  4.光學模擬分析測試整合。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 21 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資訊/控制/電信/通訊/光電/物理等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)fully-custom 或cell-based IC design。  (2)熟hspice、icfb laker、verilog、design compiler、prime time、astro/ICC、calibre或其他EDA tool。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | ASIC、類比/數位積體電路設計開發與驗測。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 22 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 材料/光電/電機/電子 | 1.材料/光電/電機/電子/物理/化學等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)半導體無塵室製程經驗。  (2)元件特性量測。  (3)修習半導體元件物理課程。  (4)具InGaAs/InP元件製程相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.黃光微影製程  2.乾/濕式蝕刻製程。  3.真空鍍膜製程  4.元件特性量測與分析。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 23 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 物理/光電/機械/電機 | 1.物理/光電/機械/電機等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下(1)~(4)任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：   1. 雷射系統架設、設計或模擬之相關經驗。 2. 光、機、電系統整合之相關經驗。 3. 處理高熱密度廢熱系統之相關經驗。   (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.開發與設計雷射系統以及光學檢測系統。  2.光、機、電系統架設、測試與整合。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 24 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 物理/光電 | 1.物理/光電等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下(1)~(4)任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：   1. 非線性光學系統架設之相關經驗。 2. 模擬光學非線性效應之相關經驗。 3. 短脈衝雷射系統設計、維護或架設之相關經驗   (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.非線性效應光學系統設計與架設。  2.高功率雷射系統非線性效應評量與應用。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 25 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/物理/材料/光電 | 1.機械/物理/材料/光電/電機/大氣等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下(1)~(3)任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)雷射與物質作用與作用機制模擬之經驗。  (2)具雷射於大氣傳播之光電物理模擬分析工作經驗。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1. 開發雷射對材料作用與模擬技術。 2. 開發雷射在大氣傳播實驗與模擬技術。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **26** | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電機/控制/光電 | 1.機械/物理/材料/光電等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下(1)~(4)任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)電路設計/整合測試經驗。  (2)數位控制程式撰寫經驗。  (3)平行運算處理/網路傳輸經驗。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.自適應光學電路設計整合測試。  2.波前感測訊號處理技術。  3.平行運算處理技術。  4.網路控制高壓驅動器。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 27 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/動力機械/機電控制/航空 | 1.電子/電機/資訊/控制/資工等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3. 具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明文件)  (1)電力電子、電源轉換、高壓脈衝電路。  (2)類比電路分析設計、佈線、測試、除錯、SPICE電路模擬。  (3)機電系統整合、設計、分析、除錯。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗等。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.電力電子、電源轉換、高壓脈衝電路。  2.類比電路分析設計、佈線、測試、除錯、SPICE電路模擬。  3.機電系統整合、設計、分析、除錯。 | 1員 | 桃 園  龍 潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 28 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電機/電子/生醫/工業工程/醫工/電信工程 | 1.電機、電子等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)數位電路設計相關經驗，具高速AD轉換、影音、通訊介面設計。  (2)系統整合相關經驗。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1. 數位控制電路設計。   2.系統整合與測試。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 29 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電機/電子/機電/機械/工業工程 | 1.機電、電機、電子、機械、工業工程等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)具伺服穩定雲台控制、馬達驅動經驗。  (2)系統整合相關經驗。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.伺服系統控制。  2.馬達控制。  3.系統整合與測試。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 30 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電機/電子/生醫/工業工程/醫工/電信工程 | 1.電機/電子/生醫/工業工程/醫工/電信工程/資工/通訊等相關理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)embedded System相關開發經驗，Arm、DSP、Zynq等。  (2)熟悉C、C++、Python、Java、C#擇一。  (3)系統整合或測試相關經驗。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.Embedded Sysem韌體程式開發。  2.系統軟體及測試程式開發。  3.系統者整合測試。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 31 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械 | 1.機械/動力機械/應用力學/光電/航空/造船/機電/控制/模具/精密工程等理工系所畢業。  2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容工作技術經驗之一者為佳(請檢附證明資料)。  (1)熟Solidworks等2D/3D軟體、ANSYS結構熱傳分析軟體操作者為佳。  (2)具備機械/結構設計/流場/熱流/熱傳/應力/靜力/動態分析等專長為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.光電產品機構設計、機電整合與系統測試，能導入專案開發過程至量產。  2.鏡頭光機/系統機構設計。 | 1員 | 桃 園  龍 潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 32 | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 電機/電子/電控/電信/工業工程 | 1.電機/電子/電控/電信/工業工程等相關理工系畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)系統組裝測試相關經驗。  (2)電路測試相關經驗。  (3)軟體測試相關經驗。  (4)電路配線相關經驗。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.系統組裝、測試  2.電路配線。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作(30%)：**  電路量測繪製  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 33 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 工業工程/生產管理 | 1.工業工程/系統工程/資訊/電子/電機/機械等理工科系畢業。  2.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)具專案管理/生產管理/採購管理/後勤支援等相關證照為佳。  (2)熟悉Office Word、Excel、Project、PPT等相關作業軟體。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 錄取後依據學經歷、專長及個人特質妥適賦予下列一或多項工作：  1.執行專案時程、預算、購案及文件管理工作。  2.執行專案計畫生產與後勤支援及產品保固管制。  3.執行財產/物料管理、生產物料資料蒐整等工作。  4.配合現地勘查、測試評估、產品解繳、行銷與展示作業，執行相關規劃整備及文案作業。  5.執行採購/供應鏈管理及協助行政庶務等工作。  6.須能配合計畫需求加班或至外地出差。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加筆試、口試)  **筆試30%**  專案管理  (70分合格)  參考書目: 專案管理知識體系指南PMBOK GUIDE第六版，作者：PMI國際專案管理學會)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 34 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 電子/電機/機械 | 1.電子/電機/電信/通訊/機械等相關理工科系。  2.具以下工作經驗或證照優先(請檢附相關證明)：  (1)電子/電路/微波。  (2)有微波電性測試系統操作經驗、電路板實作  (3))其他與工作內容所列項目相關經驗者  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件。 | 1.電性測試調校、操作。  2.測試件測試數據綜整、分析。測試件運送。  3.須能配合任務出差、加班並執行臨時性工作。 | 1員 | 新北  三峽 | **初試：**  **書面審查20%**  (70分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%**  1.電子電路錫  焊。  2.示波器或電  表等儀器操  作。  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 35 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 機械/材料 | 1.機械/模具/造船/航空/材料/化學/纖維等相關理工科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)複材製作與材料機械性質量測。  (2)車、銑床、磨床、焊接等機械加工。  (3)機械製圖、組裝、膠合與檢測。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 從事以下工作內容，並可配合輪班、出差:  1.複合材料製作及加工。  2.機械製圖、組裝、膠合與檢測及機械性質量測。  3.機械加工(含鉗工)。  4.製程夾模治具設計與製作。  5.相關生產支援、物管及備料。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (70分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%：**  機械製圖  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 36 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 材料 | 1.化學/材料/纖維/複合材料等相關理工科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照者為佳(請檢附相關證明)：  (1)材料檢測。  (2)複材預浸料製作。  (3)樹脂調配。 | 從事以下工作內容，並可配合輪班、出差：  1.材料檢測。  2.樹脂配方。  3.複材預浸料製作。  4.複材製作。  5.相關生產支援、物管及備料。 | 1員 | 桃園龍潭  及  新北三峽 | **初試：**  **書面審查20%**  (70分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%：**  複材試片製作  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 37 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 材料/鑄造/機械/電機 | 1.材料/鑄造/機械/電機/電子/航空/造船/車輛工程等相關理工科系(組)畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  2.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)機械/材料/鑄造相關工作經驗一年以上，或具相關之技術士執照或勞委會職訓局相關訓練結訓者(請檢附相關工作證明或證照影本)。  (2)電機或設備維修相關工作經驗1年以上，或具相關之技術士執照或勞委會職訓局相關訓練結訓者(請檢附相關工作證明或證照影本)。 | 從事以下工作內容，並可配合輪班、出差：  執行真空熔煉鑄造及精密鑄造等製程工作，包含：準備材料、熔鑄、後處理等製程相關設備之操作與基本維護、檢修等。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (70分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%**  1.鑄造模型製作及鑄後處理。  2.設備維修實務及電表操作、量測。  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 38 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 機械 | 1.機械、車輛工程、飛機修護、控制、模具、造船、航空等相關科系畢業。  2.需檢附專科各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)精密機械加工(車、銑床)  (2)精密機械組裝及檢測  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗者 | 從事以下工作內容，並可配合輪班、出差：  鉗工、車、銑床精密加工，包括夾治具製作、尺寸檢測等。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.機械藍圖視圖能力。  2.車/銑件加工  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 39 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 電子/電機/光電/機電 | 1.電子/電機/光電/機電/資訊等理工科系(組)畢業。  2.需檢附專科各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附證明資料)：  (1)需檢附專科(含)以上各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  (2)1年(含)以上機電整合、光電量測、電路板檢測、接頭佈線等相關工作經驗為佳。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1執行光電模組、系統製作及測試、線路配接、機台操作與維護工作。  2.檢測裝備操作、示波器量測、訊號模擬與量測、電子設備檢修。  3.電路板焊接、 組裝及測試。  4.電路板布局(熟悉Altium 、Allegro、PADS等軟體)及布局系統維護。  5.可配合輪班、調班、出差。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.電子電路錫焊。  2.示波器或電表等儀器操作。  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 40 | 材電所 | 技術類 | 高中  畢業 | 30,900  |  37,000 | 機械 | 1.機械、車輛工程、飛機修護、控制、模具、造船、航空等相關科系畢業  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件者為佳:  (1)具光學元件製作及檢測工作經驗。  (2)具光學元件鍍膜製程工作經驗。  (3)具光學鏡頭組裝及調校工作經驗。 | 從事以下工作內容，並可配合輪班、出差：  1.鏡片製作與檢測。  2.鏡頭組裝與調校。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.機械藍圖視圖能力。  2.車/銑件加工  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 41 | 材電所 | 行政  管理類 | 大學  畢業 | 33,990  |  40,000 | 專案管理 | 1. 管理、外語等相關科系畢業。 2. 具專案管理/企劃行銷2年以上相關工作經驗(需檢附相關工作經歷證明)。   3.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具2017或2018天下雜誌2000大企業專案管理經驗為佳。  4.具Office或企業管理軟體操作與應用能力。  5.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 從事以下工作內容，並可配合輪班、出差：  專案企劃與管制、行銷展示推廣、採購、物料生產管制等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **實作30%**  Excel  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 合計：研發類47員、技術類15員、行政管理類1員，合計63員 | | | | | | | | | | |

附件2

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 | |  | | ★身分證  號碼 | | | | |  | | | | 最近三個月  1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | | 年月日 | | 婚姻 | | | | | □已婚 □未婚 | | | |
| ★兵役狀況 | | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) | | | | | | | | | | | | |
| ★電子郵件 | |  | | | | | | | | | | | | |
| ★通訊處 | 戶籍  地址 |  | | | | | | | | | | 行動電話 | | |  |
| 通訊  地址 |  | | | | | | | | | | 連絡電話 | | |  |
| 居住國外在台聯絡人員  (緊急聯絡人) | |  | | 行動電話 | |  | | | | | 連絡電話 | | |  |
| ★  學歷 | 學校名稱 | | | | 院系科別 | | | | 學位 | | | 起迄時間 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★  經歷 | 服務機關名稱 | | | | 職稱(工作內容) | | | | | | | | 起迄時間 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 家庭狀況  ★ | 稱謂 | 姓名 | | | 職業 | | | | | 服務機關 | | | 連絡(行動)電話 | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三親等親屬及朋友  在中科院任職之  ★ | 關係(稱謂) | | 姓名 | | | | | 單位 | | | | | | 職稱 | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | | | | 體重：　　 　　　公斤 | | | | | | | | 血型： 　　　型 | | |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | | | | | | | | 族 別：　　　 　　　　　族 | | | | | |
| 身心  障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | | | | | | | | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) | | | | | |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 簡要自述(請以1頁說明) |
|  |

(本表若不敷使用請自行延伸)　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依報考工作編號學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修**

一、畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

二、學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

三、學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

四、英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

五、具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

六、相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

七、其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

**履歷表補充附表**

**填表日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ★**姓名** | | |  | | | | | | | |
| **2** | ★**報考職類** | | | □研發類　 □技術類　 □行政、管理類 | | | | | | | |
| **3** | ★**報考項次**  **(報考至多3個職缺為原則)** | | |  | | | | | | | |
| **4** | **前一份工作月薪** | | | 元 | | | **前一份工作年薪** | | 元 | | |
| **5** | ★**預期月薪** | | | 元 | | | ★**可接受最低月** | | 元 | | |
| **6** | **語言能力** | | |  | | | | | | | |
| **7** | **專長** | | |  | | | | | | | |
| **8** | **本院產學合作案或其他合作計畫** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 計畫名稱 |  | | | 期程 | 至 | | 本院合作單位 | | |  |
| **9** | **證照** | | | | | | | | | | **計\_\_\_\_張** |
| **10** | **論著** | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **碩士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.2** | **博士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.3** | **國內外學術期刊發表論文** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.3.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 發表期刊名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.4** | **國內外研討會發表論文** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.4.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 研討會名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.5** | **其他著作** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.5.1 | 著作名稱 | |  | | | | | | | | |

(本表若不敷使用請自行延伸) 備註：有★為必填欄位

附件3

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現職單位  （至二級） | | 姓名  (身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷  (含科/系/所) | |
|  | |  |  |  | |
| 擬參加甄選單位職缺 | | | | | |
| 報考單位(或工作編號) | | | 職類 | | 職缺 |
|  | | |  | |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | | 一級單位主管批示 | | |
| 電話： |  | |  | | |
| 一級人事單位 | |
|  | |

備註：非本院現職員工免填。